

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-196476
 (43)Date of publication of application : 03.08.1990

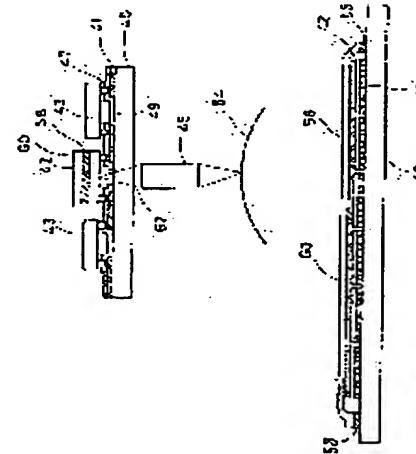
(51)Int.Cl. H01L 33/00
 B41J 2/45
 B41J 2/455
 H01L 21/60

(21)Application number : 01-015815 (71)Applicant : RICOH CO LTD
 (22)Date of filing : 24.01.1989 (72)Inventor : TAMAOKI SHUNPEI

(54) LED PRINT HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a print head which is superior in positioning accuracy and does not develop writing unevenness by mounting LED chips having individual electrode pads on light emitting faces and common electrodes on the rear located on the side opposite to the light emitting faces in such a way that they are mounted on a transparent board in a facedown bonding manner by a flip chip bonding process and the like.



CONSTITUTION: LED chips 42 equipped with a plurality of light emitting elements which are disposed in a linear form are disposed on the board 40 of an LED print head. Then the LED chips 42 have a structure in which separated electrodes are mounted on light emitting faces and common electrodes are mounted on the rear located on a side opposite to the light emitting faces. The board 40 is a transparent substrate and wiring is formed on the surface of the board 40. The light emitting faces of the LED chips 42 are facing to the surface of the board 40 and are mounted by means of facedown bonding with a flip chip bonding process where solder bumps are used. Then an electrically single extraction electrode member 60 is connected to the common electrodes which are located on the rear of the LED chips 42 through conductive adhesives 58 and light output from the light emitting faces of the LED chips 42 passes through the board 40 and its output is led out.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

BEST AVAILABLE COPY

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑪公開特許公報(A) 平2-196476

⑫Int.CI.:

H 01 L 33/00
B 41 J 2/45
2/455

H 01 L 21/60

識別記号

序内整理番号

⑬公開 平成2年(1990)8月3日

N 7733-5F

3 1 1 S

6918-5F

7612-2C B 41 J 3/21

審査請求 未請求 請求項の数 1 L (全5頁)

⑭発明の名称 LEDプリントヘッド

⑮特 願 平1-15815

⑯出 願 平1(1989)1月24日

⑰発明者 玉置俊平 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑱出願人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑲代理人 弁理士 野口繁雄

明細書

1. 発明の名称

LEDプリントヘッド

2. 特許請求の範囲

(1) 直線状に配列された複数の発光素子を備えたLEDチップを、各LEDチップの発光素子が一直線状に並ぶように基板上に配置したLEDプリントヘッドにおいて、LEDチップは発光面に個別電極が設けられ、反対側にある裏面に共通電極が設けられた構造をしており、基板は透明基板であり、基板裏面には配線が形成されており、LEDチップの発光面が基板裏面と対向して半田バンプを用いたフリップチップ法によりフェイスダウン法で実装されており、LEDチップ裏面の共通電極には導電性接着剤により電気的に单一の引出し電極部材が接続されており、LEDチップ発光面からの光出力が前記基板を通過して取り出されることを特徴とするLEDプリントヘッド。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は前記記録用に用いるLEDプリントヘッドに関するものである。

(従来の技術)

LEDプリントヘッドでは、直線状に配列された複数の発光素子を備えたLEDチップを、各LEDチップの発光素子が一直線状に並ぶよう基板上に配置されている。

LEDチップは発光面に個別電極が設けられ、反対側にある裏面に共通電極が設けられた構造をしている。

第7図に示されるように、LEDチップ2はセラミックやアルミニウムなどの不透明な基板4上に、発光面を基板4と反対側に向けて、LEDチップ2の裏面にある共通電極が導電性接着剤6によって基板4の共通電極8と接続され、発光面の個別電極と基板4の個別引出し電極10の間はワイヤ12によって接続が施される。

(発明が解決しようとする課題)

LEDチップ2をワイヤボンディング法により基板4に実装する場合、LEDチップ2を基板4

に取りつける際の位置決め精度が低く、したがって LED プリントヘッドとして書き込みむらが発生する。

I C チップを位置決め精度よく実装する方法として、フリップチップ法によるフェイスダウンボンディングのセルフアライメント機能を利用する方法がある。LED プリントヘッドにフリップチップ法を用いて LED チップ 2 を取りつけようすると、フェイスダウン実装においては、通常は全ての電極をチップ表面、LED チップ 2 では発光面に集めることが必要である。もし、個別電極のみならず共通電極も発光面に形成するとすれば、第 8 図及び第 9 図に示されるように、LED チップ 14 の個別電極パッド 16、共通電極パッド 18 が発光部 20 のある発光面に形成されることになり、発光面での接続パッド数が増えてチップサイズが大きくなる欠点がある。なお、第 8 図は LED チップ 14 の主要部の断面構造を示しており、24 は GaAs、26 は GaAs...P...、28 は Zn 拡散領域、30、32 は絶縁層である。

チップ発光面が透明基板表面と対向するので、発光素子からの光は透明基板を通して取り出される。

(実施例)

第 1 図は一実施例を発光素子配列方向と直交する方向に切断した断面図、第 2 図は発光素子配列方向に沿って切断した断面図、第 3 図は一実施例で用いられる LED チップの主要部の断面図、第 4 図は同 LED チップの発光面を表わす平面図である。

40 は透明基板であり、例えば珪酸ガラスを用いる。基板 40 の表面には必要な配線電極パターン 41 が厚膜金属層又は薄膜金属層を写真露版とニッティングによってパターン化することにより形成されている。配線電極材料としては、厚膜の場合は金属電極がエッティング精度の点から望ましく、薄膜の場合 A_u 又は NiCr/A_u や Cr/C_u などの積層構造のものが基板ガラスとの接着性の面から望ましい。配線電極パターン 41 は、外部との電気接続を行なう部分、実装される LED チップ 42 やそれを駆動する駆動用 I C チップ 4

本発明は、発光面には個別電極パッドをもち、共通電極を反対側の表面にもつ LED チップを、位置決め精度の高いフリップチップ法によるフェイスダウンボンディングにより実装することによって、上記の課題を解決することを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明では、基板として表面に配線が形成された透明基板を用いる。LED チップの発光面が基板表面と対向するように、LED チップを半田バンプを用いたフリップチップ法によりフェイスダウン法で実装し、LED チップ裏面の共通電極には導電性接着剤により電気的に单一の引出し電極部材を接続し、LED チップ発光面からの光出力を透明基板を通して取り出す。

(作用)

LED チップ発光面にある個別電極はフリップチップ法によって透明基板表面の配線と接続され、LED チップ裏面の共通電極は引出し電極部材によって透明基板表面の配線と接続される。LED

3 のボンディング接続を行なう電極パッド部分、LED チップ 42 の裏面の共通電極と接続される引出し電極部材 60 と基板 40 との接続部分、及び出力された光が収束性ロッドレンズ(セルフオックレンズ) 45 へ入射する経路にあたる部分を除いて、絶縁膜 49 によって被覆されている。絶縁膜 49 による被覆は、フェイスダウンボンディングに用いる半田バンプがリフロー接続時に基板パッド部以外の電極部へ液出したり、短絡するのを防ぐためと、電極材の腐食を防ぐためである。また、絶縁膜 49 の開口部の電極 41 には半田バンプによる電極の溶食を防止するために Ni、Cuなどをメッキ法により形成し、ついでボンディング時の半田濡れ性向上のために Au、P などがメッキ法により形成されている。

42 は LED チップであり、LED チップ 42 の発光面には発光部 44 と個別電極パッド 46 が形成されており、個別電極パッド 46 には半田バンプ 47 が形成される。LED チップ 42 は発光面が基板 40 便を向くように配置され、フリップ

チップ法でフェイスダウンボンディングされている。発光部44は第1回においては基面垂直方向の一直線上に配列され、第2回においては面内方向の一直線上に配列されるように、LEDチップ42が基板40上で位置決めされている。44はLEDチップ42を駆動するためのICチップであり、ICチップ44もフリンプチップ法によりフェイスダウンボンディングされている。

LEDチップ42においては、その裏面、すなわち発光面と反対側の面には共通電極52が形成されている。LEDチップ42の断面構造は、例えば第3回に示されるものである。48はGaAs層、50はGaAs_xP_{1-x}層、51はZn拡散領域であり、個別電極46がZn拡散領域52と接続されている。裏面には共通電極52が形成されている。54、56は絶縁層である。個別電極46としては例えばアルミニウム層が用いられ、共通電極52としては例えばAu—Ge—Ni層が用いられる。

基板40上に実装されたLEDチップ42の四

面には、導電性接着剤58によって引出し電極部材60が全てのLEDチップ42の共通電極と接続され、引出し電極部材60はまた、基板40上の共通電極部分にも導電性接着剤58によって接続されている。導電性接着剤58としては例えばAu系もしくはAg系のエポキシ樹脂を用いることができる。導電性接着剤58と引出し電極部材60によって、LEDチップ42は基板40の配線電極41と電気的及び熱的に良好な接続がなされる。引出し電極部材60は引出し共通電極であるとともに、放熱用のヒートシンクともなっている。

LEDチップ42の発光部44から出力される光62は、収束性ロッドレンズ45によって感光ドラム64の表面に集光される。

LEDチップ42は、それ自身が動作中に発熱する。LEDチップの発光効率は、第5回に示されるように、昇温によって低下する。そのため、LEDチップ42の昇温防止を目的として、従来のワイヤボンディング法による実装法では、基板

としてセラミックやアルミニウムなどの熱伝導率の大きい、すなわち放熱性のよい材料が用いられてきた。しかしながら、本実施例では基板40として光学的に透明なガラス基板を用いている。ガラスは比較的熱伝導性が悪く、基板以外の放熱手段が必要である。上記の実施例では引出し電極部材60がその放熱手段となっている。

実施例においては、LEDチップ42の裏面に板状の引出し電極部材60を接着しているので、引出し電極部材60と基板40との熱膨張係数の差が大きければプリントヘッド自体に反りが発生したり、LEDチップ42の接続部又はLEDチップ42自体が応力によって破壊することができる。そこで、好ましくは、LEDチップ40と引出し電極部材60の熱膨張係数を等しくすることである。そこで、好ましい例としては、引出し電極部材60の材質としてグラッド材を用いる。例えば、基板40として一般的な透明ガラスであるコーニング7059を用いるとすれば、引出し電極部材60としてCu/インバース/Cuの積層グラッ

ド材で、厚さの比が2:1.5:2であるものを用いると、引出し電極部材60と基板40の熱膨張係数がともに $4.6 \times 10^{-6}/\text{deg}$ となり、好都合である。このように、基板40と引出し電極部材60の熱膨張率の差がなくなれば、バイメタル効果による反りやLEDチップ42の破壊を防ぐことができる。

第6回はLEDチップ42の放熱特性をさらに改良した実施例を表わしている。

LEDチップ42の裏面に導電性接着剤56によって引出し電極部材60が接続されており、さらに外枠66にヒートシンク材68を設け、引出し電極部材60とヒートシンク材68を密着させることにより、LEDチップ42の放熱を一層効率良く行なうことができる。

(発明の効果)

本発明では、LEDチップを、半田バンプを用いたフリンプチップ法によりフェイスダウンボンディングすることにより、位置決め精度がよくなつて書き込みむらがなくなる。

また、LEDチップの発光面と反対側の面に共通電極を設けて引出し電極部材と接続することによって、発光面に共通電極を設けなくてもすみ、その結果、チップサイズが増大するのを防ぎ、コスト高になることを防ぐことができる。

4. 図面の簡単な説明

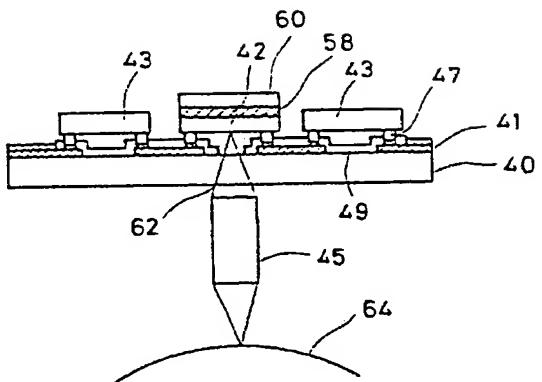
第1図は一実施例を発光素子配列方向と直交する方向に切断した断面図、第2図は同実施例を発光素子配列方向に沿って切断した断面図、第3図は一実施例で用いられるLEDチップの主要部を示す断面図、第4図は同LEDチップの発光面を示す平面図、第5図はLEDチップの発光出力と温度の関係を示す図、第6図は他の実施例を発光素子配列方向と直交する方向で切断した断面図、第7図は従来のワイヤボンディング法により実装されたLEDチップを示す断面図、第8図はフリップチップ実装を想定した場合に考えられるLEDチップの主要部を示す断面図、第9図は同LEDチップの発光面を示す平面図である。

40……透明ガラス基板、41……配線電極、

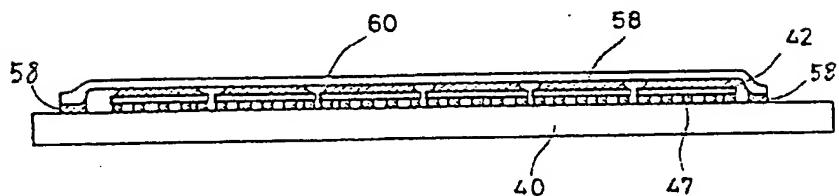
42……LEDチップ、43……駆動用ICチップ、44……発光部、46……個別電極パッド、52……共通電極、58……導電性接着剤、60……引出し電極部材、66……外枠、68……ヒートシンク。

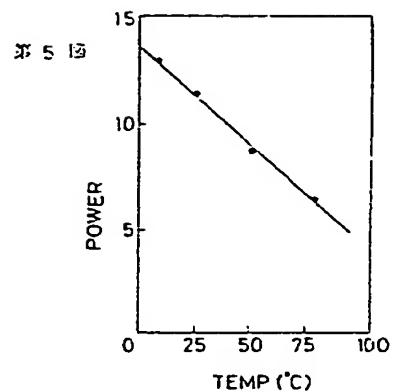
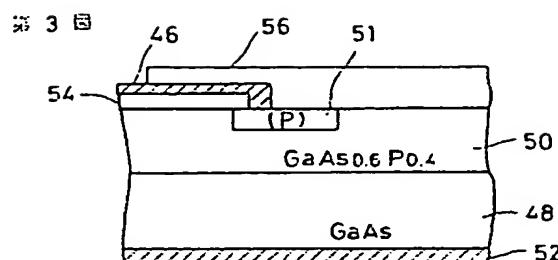
特許出願人 株式会社リコー
代理人 井理士 野口敏哉

第1図

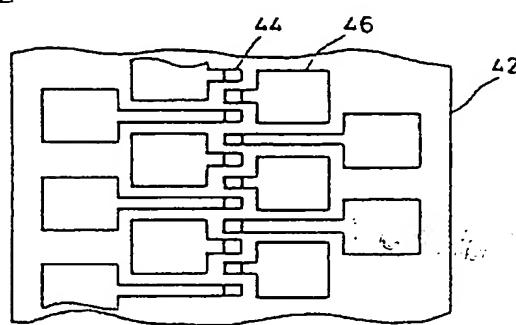


第2図

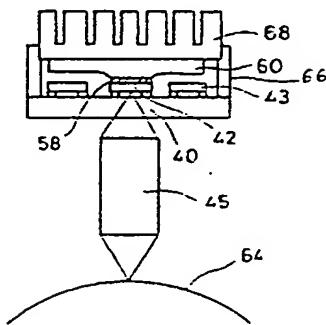




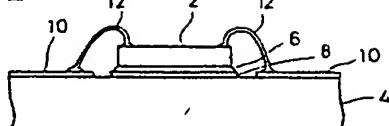
第4図



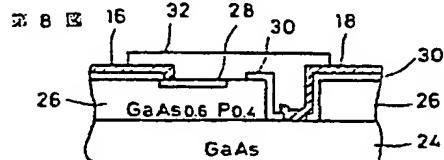
第6図



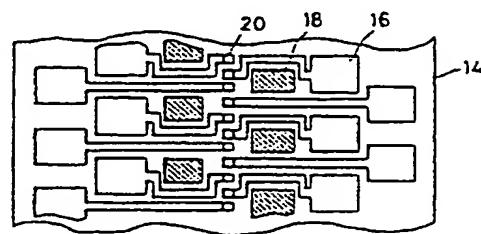
第7図



第8図



第9図



THIS PAGE BLANK (USPTO)